

无硅导热垫片

TP400-H60-SF是一款无硅导热垫片，专门为对有机硅敏感应用而设计、开发的一种高导热、高强度、阻燃的界面导热材料，可以满足高压缩、多次重工、抗撕裂、高频震动冲击等多种应用场合。

特性和优点

- 导热系数4.0 W/(m·K)
- 无硅油析出或硅氧烷挥发
- 良好的机械性能
- 弱粘性
- 高绝缘
- 耐用性好
- 高压缩

典型应用

- 光纤模块
- 医疗设备
- 硬盘驱动器
- 光学精密设备
- 高端工控设备
- 有机硅敏感元件/设备/产品
- 汽车传感器/控制模块

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	绿色	目视
厚度(mm)	0.5~4.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.0	ASTM D792
硬度(Shore 00)	60	ASTM D2240
重量损失(%)	≤1.0	滤纸吸附@压缩25%/125°C/48h
防火性能	V-0	UL 94
耐温范围(°C)	-40~125	/
保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥6.0	ASTM D149
体积电阻率(Ω·cm)	10 ¹¹	ASTM D257
介电常数	5.7	ASTM D150
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	4.0	ISO 22007-2